EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2003023019

PUBLICATION DATE

24-01-03

APPLICATION DATE

05-07-01

APPLICATION NUMBER

2001204874

APPLICANT: TOKYO WELD CO LTD;

INVENTOR :

HIRAI KOJI:

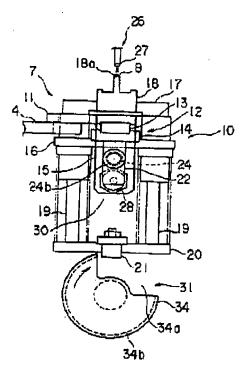
INT.CL.

H01L 21/50 H01L 23/50

TITLE

APPARATUS AND METHOD FOR

SEPARATING/TRANSFERRING **ELECTRONIC COMPONENT**



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus for separating/transferring electronic components capable of increasing the transferring speed of the electronic components to correspond with the speed of separating/transferring means for transferring the components from a separating/transferring part to the next process.

> SOLUTION: In the separating/transferring apparatus composed of a stamping part 9 for stamping out a plurality of electronic components 2 arranged in the width direction and the longitudinal direction of a lead frame 1 from the lead frame 1 and separating them into individual electronic component columns 8, a transfer table 4 for rotatably transferring the electronic component column 8 stamped out at the stamping part 9, and a separating/transferring part 10 for separating the electronic component column 8 transferred by the transfer table 4 into Individual electronic components 2 and transferring them to the next process, the apparatus is characterized in that the transfer table 4 is provided with a plurality of transfer mechanisms 7, and the electronic component column 8 is placed on the transfer mechanism 7 to be transferred from the stamping part 9 to the separating/transferring part 10.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-23019

(P2003-23019A) (43)公開日 平成15年1月24日(2003.1.24)

(51) Int.Cl.7 酸別制 号

HOIL 21/50

23/50

FI

H01L 21/50

23/50

ケーアコート*(参考)

С 5F 0 6 7

 \mathbf{B} Z

審査請求 未請求 請求項の数10 ()L (全 6 頁)

(21)出顧番号

特顧2001-204874(P2001-204874)

(22) 川瀬日

平成13年7月5日(2001.7.5)

(71)出願人 591009705

株式会社 東京ウエルズ

東京都大田区北周込2 丁目28番1号

(72) 発明者 平川 文廣

東京都大田区北周込2 「目28番1号 株式

会社東京ウェルズム

(72)発明者 服部 省悟

東京都大田区北馬込2「目28番1号 株式

会社東京ウエルズ内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外 5 名)

最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 電子部品の分離・搬送装置及び分離・搬送方法

(57)【 契約】

【課題】電子部品の蝦送速度を高速化し、分離・搬送部 から次の工程に移送する分離・搬送手段の速度に対応さ せることができる電子都品の分離・搬送装置を提供する ことにある。

【解決手段】リードフレーム1の幅方向及び長手方向に 配列された複数個の電子部品2を、前記リードフレーム 1から打抜いて個々に分離した電干部品列8とする打抜 き部9と、この打抜き部9で打抜かれた前記電子部品列 8を回転搬送する搬送デーブル4と、この搬送テーブル 4により搬送された前記電子部品列8を個々の電子部品 2に分離し、次の工程に移送する分離・搬送手段26を 有する分離・搬送部10とからなる分離・搬送装置にお いて、前記搬送テーブル4に複数の搬送機構でを設け、 前記搬送機構7に前記電子部品列8を載置して前記打抜 き部 9 から前記分離・搬送部 1 0 へ搬送することを特徴 とする。

